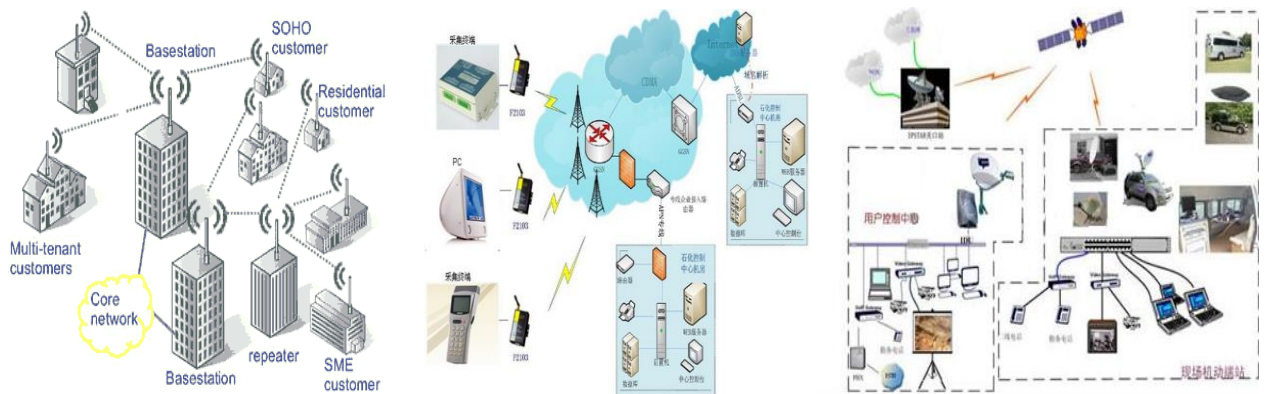


GT3150 高频电路板基材

产品规格书

一、产品简介



GT3150 产品，是碳氢树脂加以填充粉料，使用玻璃纤维布增强的一种板材。本产品介电常数小、介质损耗小，板材在频率 GHz 级以上使用，介电常数稳定，适用于宽频应用，并具有优良的机械加工性能，印制电路板加工工艺、过程与传统 FR-4 板材相似。

二、特性及应用领域

特性

- * 低介电常数
- * 低介质损耗
- * 低膨胀系数
- * 优异的尺寸稳定性

应用领域

- * 无线通信网络
- * 卫星通信设备
- * 微波天线
- * 高频设备器件

三、技术参数

序号	性能	典型值	方向	单位	条件	测试方法
		GT3150				
1	介电常数(Dk)	3.5±0.05	Z	-	10 GHz 23℃	IPC-TM-650 2.5.5.5
2	介质损耗(Df)	0.0045±0.0005	Z	-	10 GHz 23℃	
3	体积电阻	2.4*10 ⁴	X, Y	MΩ*cm	COND A	IPC 2.5.17.1
4	表面电阻	1.8*10 ⁶		MΩ	COND A	IPC 2.5.17.1
5	吸水率	<0.3		%	D24/23	IPC-TM-650 2.6.2.1
6	导热系数	0.3	-	W/m/K	80℃	ASTM C518
7	热膨胀系数	17/19 38	X/Y Z	ppm/℃		ASTM D3386-94
8	热裂解温度	390		℃	TGA	ASTM D3850
9	密度	1.8		gm/cm ³		
10	剥离强度	>0.80		N/mm	H oz	IPC-TM-2.4.8
11	阻燃	V-0				UL94
12	兼容无铅制程	是				

四、板材常规规格

标准厚度	标准尺寸	标准铜箔
0.25mm 0.50mm 0.75mm 1.00mm	41inch X 49inch 18inch X 24inch 12inch X 18inch	½ oz. (18 μm) 电解铜箔 HTE (H/H) 1 oz. (35 μm) 电解铜箔 HTE (1/1)

注：如有需要可以提供其他厚度、其他尺寸的板,可能要用到的其它型号铜箔,请联系客户服务。本产品按照 FR-4 板 PCB 加工工艺参数作业,如果需要更详细的信息请联系客户服务。

五、包装及运输

- 1、内包装：淋膜纸包装，每包 15pcs。
- 2、外包装：平放于木质栈板上，用打包带固定，可多包叠在一起，外贴产品标签贴纸（内容包括：产品品名、料号、数量、规格、批号等）。
3. 运输方式：GT3150 高频微波覆铜板不属于易燃易爆危险品，按普通商品运输处理，适用于陆运、海运和空运等运输方式。

六、贮存条件

- 1、存放方式：以原包装形式放在平台上或合适的架上，避免重压，防止存放方式不妥而引起的板材变形。
- 2、存放环境和贮存期限：板材宜存放于阴凉、通风、干燥、室温、干净的环境下，避免阳光直射、雨淋，避免腐蚀性气体的侵蚀（存放的环境直接影响板材的品质），在此合适的环境下可以贮存二年。

七、服务方式

公司名称：高斯贝尔数码科技股份有限公司

地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

电话：86-0735-2666666-8636

传真：86-0735-2659922

公司网址：www.gospell.com